HPC SYSTEMS

NVIDIA® T4搭載、PoE×6・USB3.0×6を装備 Edgecross推奨産業用PC認証取得モデル

NVIDIA® T4搭載のハイエンド小型エッジサーバー

ハイパフォーマンスコンピューティング、ディープラーニングのトレーニングと推論、機械学習、データ分析などに強いNVIDIA® T4を搭載したハイエンド小型エッジサーバーは、クラウドで行っていた処理の一部をエッジで実行することにより、「レイテンシの向上」や「通信コストの削減」などを実現します。

ハイエンドGPUを冷却し安定動作させる、優れた排熱機構

小型の筐体にパッシブ冷却のNVIDIA® T4を実装するには、十分に排熱できるエアフローが必要です。GPUの温度が高くなると、サーマルスロットリングが働き、処理速度の低下を招くことがあります。EDG-INT4-G1は、NVIDIA® T4から発生する熱を効率良く外気へと送り出すGPU用ブロアファンとメッシュ構造の排熱口を実装することで、安定動作を可能にしています。

筐体底面イメージ

intel CORE i7 7th Gen　intel XEON inside

NVIDIA® T4搭載モデル

EDG-INT4-G1

EDGECROSS

- Turing™ 世代GPU「NVIDIA® T4」搭載
- PoEポート×6基
- LANポート×3基
- USB3.0ポート×6基
- COMポート×2基
- 19V～36V DC-in
- 280W(24V)ACアダプター付属
- 16 DIO (8 DI、8 DO)装備
- 2.5"リムーバブルディスク×1基搭載可能

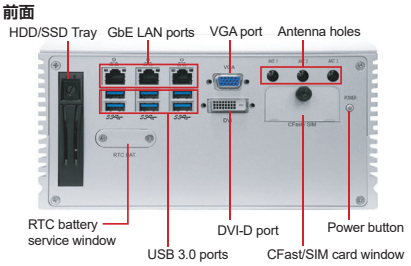
※写真はイメージです

■製品仕様

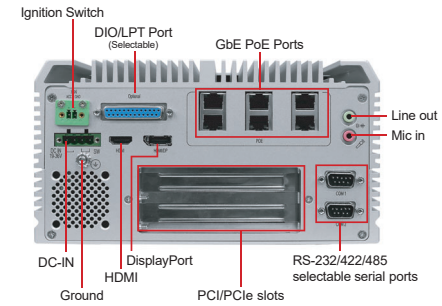
製品名		EDG-INT4-G1
プロセッサー	種類	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1268L v5 (4コア8スレッド、2.40GHz、35W TDP) インテル® Core™ i7- 7700Tプロセッサー (4コア8スレッド、2.90GHz、35W TDP) インテル® Core™ i5-7500Tプロセッサー (4コア4スレッド、2.70GHz、35W TDP) インテル® Core™ i3-7101TEプロセッサー (2コア4スレッド、3.40GHz、35W TDP)
	搭載数	1
チップセット		インテル® C236
メモリー	規格	DDR4 SO-DIMM、2133MHz SDRAM
	容量	最大32GB
	スロット数	2
ストレージデバイス	CFast ソケット	1
	2.5" SSD/HDD	2（リムーバブル×1、内蔵×1）
GPU		インテル® HDグラフィックス、NVIDIA® T4
I/O	シリアル (COM)	2 ※RS-232/422/485
	USB	6 (USB3.0)
	VGA	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	DVI-D	1
	DIO	16 (8 DI、8 DO)※もしくはLPTポートが選択可能。デフォルトはDIO
	LPT	1 (オプション) ※デフォルトはDIO
	Ethernet	2 (インテル® WGI211AT GbE) 1 (インテル ® WGI219LM GbE、iAMT 11.0)
	PoE	6（802.3af Gigabit PoE ports）
オーディオ		Mic-in / Line-out
拡張スロット	PCI-Express x16	1 ※GPUで使用
	PCI-Express x8	1 (x4シグナル) ※搭載するカードの仕様により制限があります。
	Mini-PCI Express	2
SIMスロット		1
対応OS		Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise LTSC 2019 Ubuntu 18.04 LTS ※Ubuntuを選択する場合、Edgecoressは認証していません。
電源	入力電圧	DC 19～36V
	電源入力タイプ	4ピンDC電源入力ターミナルブロック(リモート電源ON/OFFスイッチ)
	イグニッションコントロール	2ピンターミナルブロック：IGN、GND
	消費電力	最大280W
外観寸法 (W×D×H)		225mm×292mm×120mm
重量		約7.2kg
取り付け方法		ウォールマウント用ブラケット
動作温度		最大0℃～+45℃

■I/Oポート

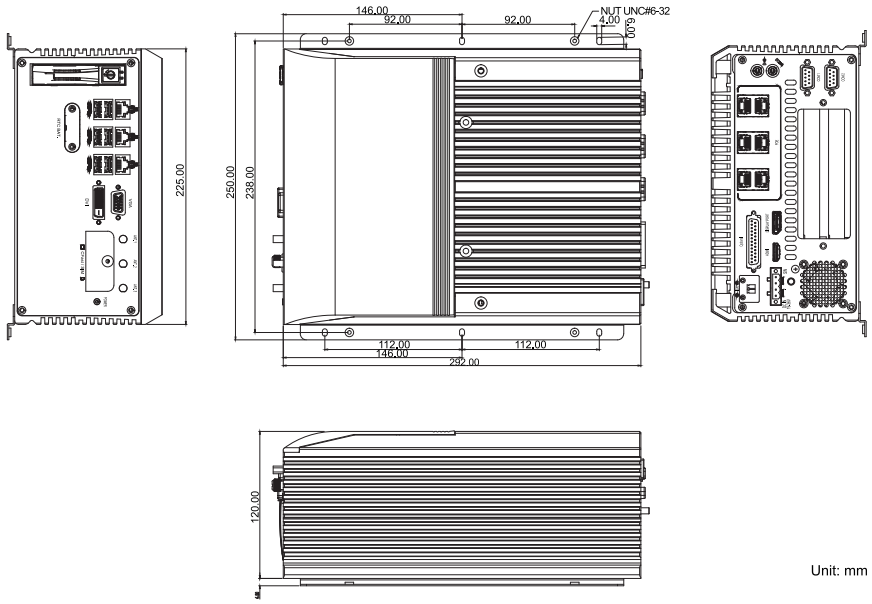
前面



背面



■外観寸法



Unit: mm

HPC SYSTEMS

HPCシステムズ株式会社　CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間：9:00～18:00（土日、祝日、年末年始を除く）
TEL：03-5446-5535　mail：cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト：https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2020年6月現在の内容です。